

FOGALE nanotech

T-MAP DUAL 3D

> LE PRODUIT : T-MAP DUAL 3D

Les technologies 3D permettent d'empiler les composants électroniques au moyen de Via traversant. Cette nouvelle approche nécessite le recours à des étapes de fabrication spécifiques. L'équipement T-MAP DUAL 3D de FOGALE nanotech, combinant microscopie et interférométrie, permet de contrôler toutes ces étapes. La solution FOGALE, brevetée et unique sur le marché, a déjà été adoptée par les plus grands acteurs du secteur (IBM, Samsung, HP, TSMC, Fairchild, etc...).

L'équipement FOGALE T-MAP DUAL 3D a reçu le prix de la meilleure solution de métrologie et d'inspection pour les applications semi-conducteurs 3D au Semicon West 2014 (Juillet 2014, San Francisco, CA, USA).



> PRODUIT ISSU DU PROJET

- SmartStack
- Appel à projets : FUI AAP6
- Budget : 5.5M€
- Durée du projet : 30 mois
- Fin du projet : Septembre 2011

> LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

- Création de près de 20 emplois
- Prévisions de chiffre d'affaires de 6.5 M€ pour 2015, 18M€ à horizon 2017, dont 95% à l'export
- 8 brevets déposés

> SITE WEB

- www.fogale-semicon.com/products/t-map-dual-3d

> L'ENTREPRISE

FOGALE nanotech

Entreprise d'ingénierie de haute technologie, FOGALE nanotech innove depuis plus de 20 ans dans le domaine de la mesure dimensionnelle. Notre réputation d'expert scientifique en mesures optiques, capacitatives, inductives et ultrasonores nous permet d'être présents sur de grands projets de développements nationaux et internationaux dans des secteurs aussi variés que l'industrie, l'aéronautique, le génie civil, les biotechnologies, le spatial, les nanotechnologies, le nucléaire... FOGALE nanotech est membre actif du pôle de compétitivité SCS depuis 2008.